

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名: XCL208xxxxDR  
標準質量: 16.5 mg

部位	名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
コイル	コア(フェライト)	3.650	酸化鉄	221200	1309-37-1
		0.800	酸化亜鉛	48500	1314-13-2
		0.660	酸化ニッケル	40000	1313-99-1
		0.200	酸化銅	12100	1317-38-0
		0.030	酸化錫	1800	18282-10-5
	内部導体	0.210	銀	12700	7440-22-4
	端子電極	0.250	銀	15200	7440-22-4
		0.050	ニッケル	3000	7440-02-0
	0.150	錫	9100	7440-31-5	
鉛フリー はんだ	鉛フリーはんだ	0.913	錫	55300	7440-31-5
		0.048	アンチモン	2900	7440-36-0
IC	シリコンチップ	0.666	シリコン	40400	7440-21-3
		-	ヒ素	<1	7440-38-2
	リードパッド	0.906	ニッケル	54900	7440-02-0
		0.086	銀	5200	7440-22-4
		0.010	金	600	7440-57-5
	ダイアタッチ	0.218	溶融シリカ	13200	60676-86-0
		0.141	ビスマレイミド樹脂	8600	-
		0.054	アクリル樹脂	3300	-
		0.039	エポキシ樹脂	2300	-
	ボンディングワイヤ	0.071	金	4300	7440-57-5
	封止樹脂	6.588	溶融シリカ	399300	60676-86-0
		0.349	エポキシ樹脂	21100	-
	0.233	フェノール樹脂	14100	-	
	0.155	金属水酸化物	9400	-	
	0.023	結晶シリカ	1400	14808-60-7	

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。